



苏州固得电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

产品规格书

Specification

GOODARK型号

BZV55C2V4~BZV55C75

构造 : 稳压二极管

Construction : Small-Signal Diode

用途 : 稳压

Application : Zener Rectifier

制造工厂 (Manufacturer) :

苏州固得电子股份有限公司

Suzhou Good-ark Electronics Co., Ltd

作成部门: 产品开发事业部

Prepared: R & D Department

批准人 : 蒋祖良

Confirmed: Z.L.Jiang

接受印栏

请记入贵公司的名称、接受日期、责任者人名。

记载内容

CONTENTS

- | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|
| 1. | 外形规格 | CASE DIMENSION |
| 2. | 内部结构 | INTERNAL FRAME |
| 3. | 印字规格 | MARKING |
| 4. | 编带规格 | TAPING SPECIFICATION |
| 5. | 最大定格 | ABSOLUTE MAXIMUM RATING |
| 6. | 电气特性 | ELECTRICAL CHARACTERISTICS |
| 7. | 特性曲线 | RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES |
| 8. | 包装规格 | PACKAGING SPECIFICATION |
| 9. | 其他项目 | OTHER ITEM |
| 10. | 可靠性试验 | QUALITY ASSURANCE TEST CONDITION |



苏州固得电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

变更履历

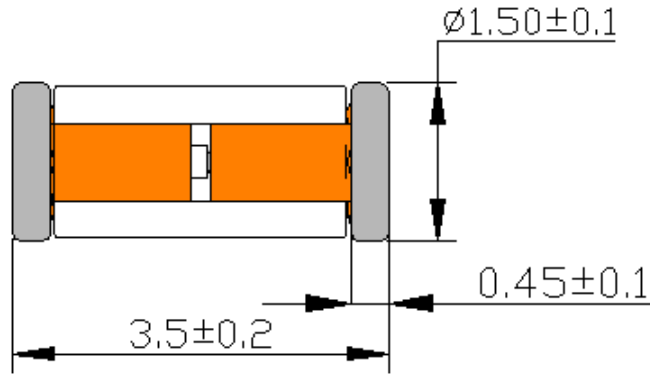
发行日	变更种类	变更号	变更内容	实施日期



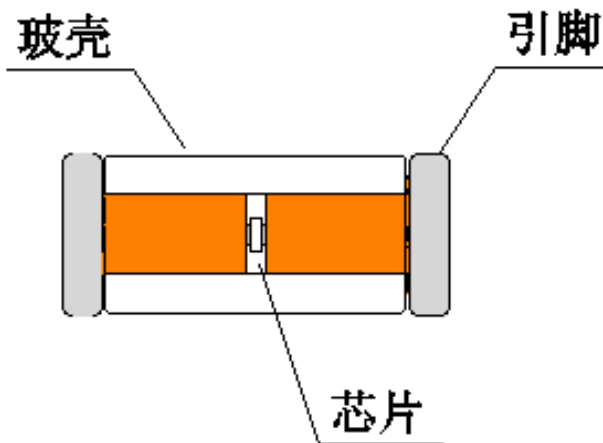
苏州固得电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

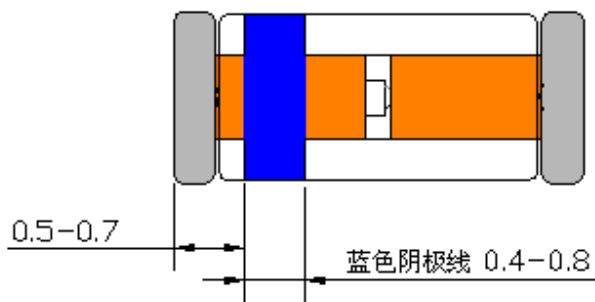
1.外形规格 CASE DIMENSION (Mini MELF Type) Unit mm



2.内部结构 BOSOM FRAME



3.印字规格 MARKING

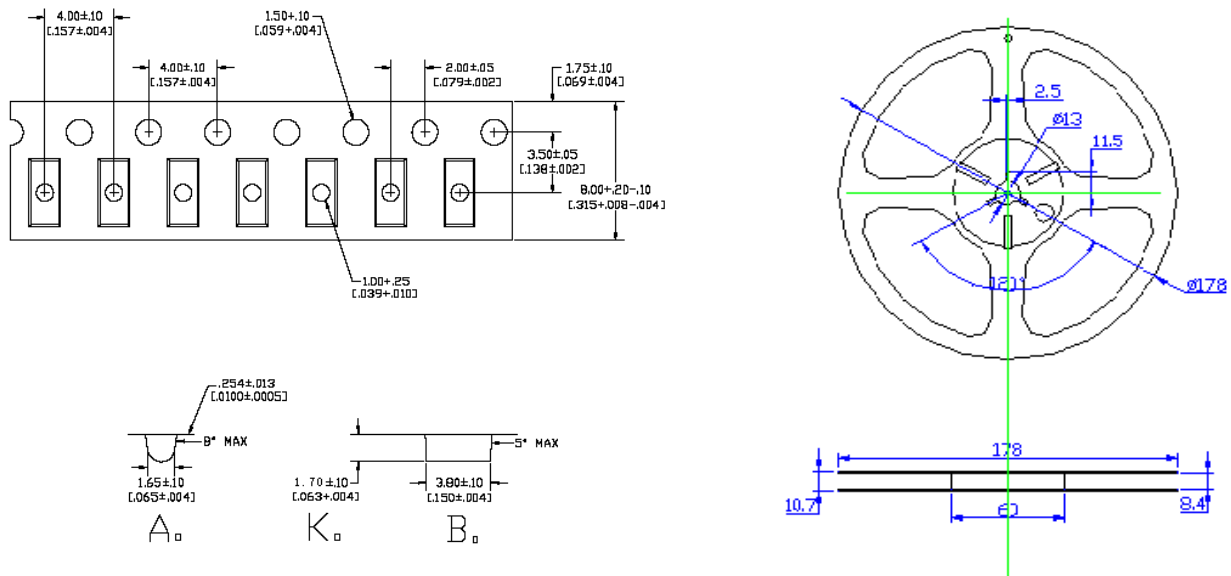




苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

4. 编带规格 TAPING SPECIFICATION, 厚度: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$, 单位: mm。



5. 最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATING ($T_a=25^\circ\text{C}$)

项目 ITEM	符号 SYMBOL	定格 LIMIT	单位 UNIT
许容损失 Power Dissipation $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P _{tot}	500	mW
接合温度 Maximum Junction Temperature	T _j	175	°C
保存温度范围 Storage Temperature	T _{stg}	-55~175	°C



苏州固锴电子股份有限公司

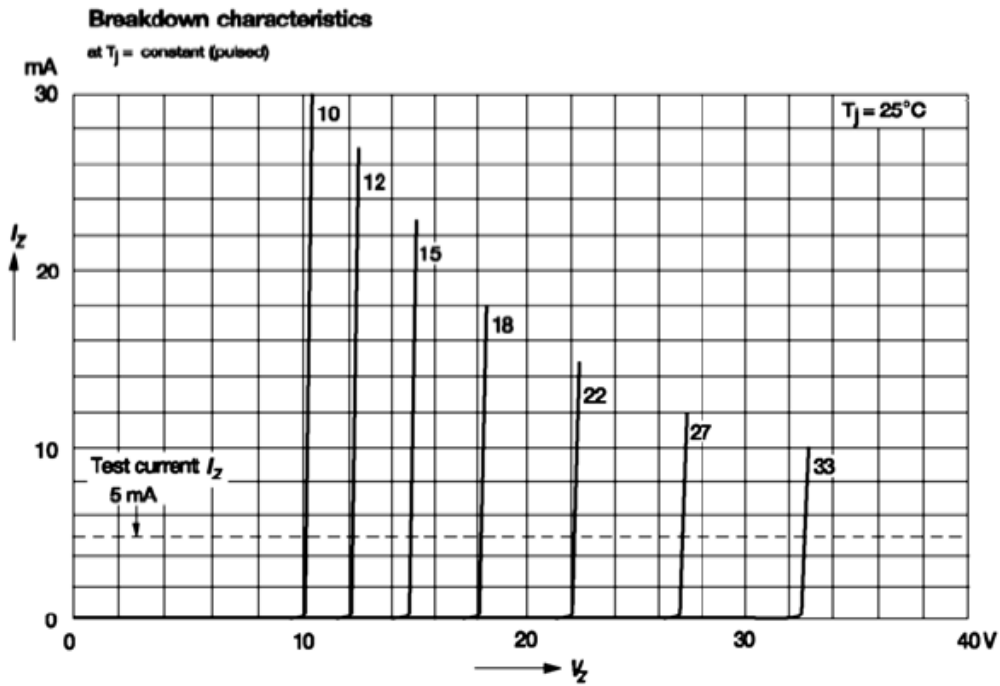
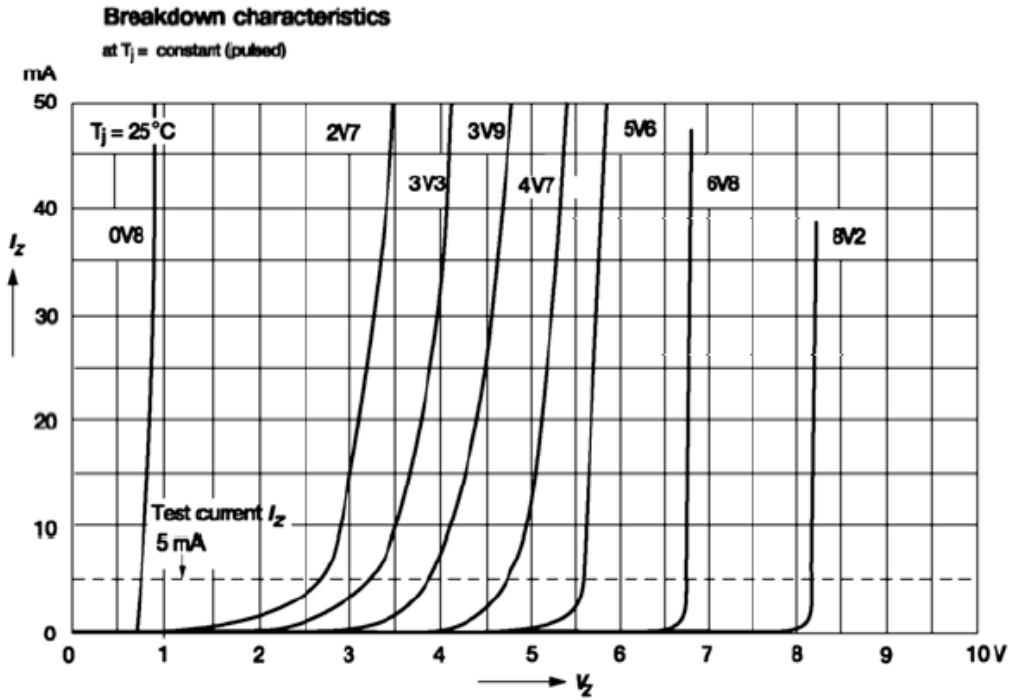
SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

6. 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

序号	规格	参数 @IZ (mA)	Vz (v)		@IzT (mA)	ZzT ohms (Max)	@IzK (mA)	ZzK ohms (Max)	@VR (V)	IR(uA) Max	@IF (mA)	VF(V) Max
			Min	Max								
1	BZV55C 2V4	5	2.20	2.60	5	100	1	600	1	50	10	0.9
2	BZV55C 2V7	5	2.50	2.90	5	100	1	600	1	20	10	0.9
3	BZV55C 3V0	5	2.80	3.20	5	95	1	600	1	10	10	0.9
4	BZV55C 3V3	5	3.10	3.50	5	95	1	600	1	5	10	0.9
5	BZV55C 3V6	5	3.40	3.90	5	90	1	600	1	5	10	0.9
6	BZV55C 3V9	5	3.70	4.10	5	90	1	600	1	3	10	0.9
7	BZV55C 4V3	5	4.00	4.60	5	90	1	600	1	3	10	0.9
8	BZV55C 4V7	5	4.40	5.00	5	80	1	500	2	3	10	0.9
9	BZV55C 5V1	5	4.80	5.40	5	60	1	480	2	2	10	0.9
10	BZV55C 5V6	5	5.20	6.00	5	40	1	400	2	1	10	0.9
11	BZV55C 6V2	5	5.80	6.60	5	10	1	150	4	3	10	0.9
12	BZV55C 6V8	5	6.40	7.20	5	15	1	80	4	2	10	0.9
13	BZV55C 7V5	5	7.00	7.90	5	15	1	80	5	1	10	0.9
14	BZV55C 8V2	5	7.70	8.70	5	15	1	80	5	0.7	10	0.9
15	BZV55C 9V1	5	8.50	9.60	5	15	1	100	6	0.5	10	0.9
16	BZV55C 10	5	9.40	10.60	5	20	1	150	7	0.2	10	0.9
17	BZV55C 11	5	10.40	11.60	5	20	1	150	8	0.1	10	0.9
18	BZV55C 12	5	11.40	12.70	5	25	1	150	8	0.1	10	0.9
19	BZV55C 13	5	12.40	14.10	5	30	1	170	8	0.1	10	0.9
20	BZV55C 15	5	13.80	15.60	5	30	1	200	10	0.05	10	0.9
21	BZV55C 16	5	15.30	17.10	5	40	1	200	11	0.05	10	0.9
22	BZV55C 18	5	16.80	19.10	5	45	1	225	13	0.05	10	0.9
23	BZV55C 20	5	18.80	21.20	5	55	1	225	14	0.05	10	0.9
24	BZV55C 22	5	20.80	23.30	5	55	1	250	15	0.05	10	0.9
25	BZV55C 24	5	22.80	25.60	5	70	1	250	17	0.05	10	0.9
26	BZV55C 27	2	25.10	28.90	2	80	0.5	300	19	0.05	10	0.9
27	BZV55C 30	2	28.00	32.00	2	80	0.5	300	21	0.05	10	0.9
28	BZV55C 33	2	31.00	35.00	2	80	0.5	325	23	0.05	10	0.9
29	BZV55C 36	2	34.00	38.00	2	80	0.5	350	25	0.05	10	0.9
30	BZV55C 39	2	37.00	41.00	2	90	0.5	350	27	0.05	10	0.9
31	BZV55C 43	2	40.00	46.00	2	130	0.5	375	30	0.05	10	0.9
32	BZV55C 47	2	44.00	50.00	2	170	0.5	375	33	0.05	10	0.9
33	BZV55C 51	2	48.00	54.00	2	180	0.5	400	36	0.05	10	0.9
34	BZV55C 56	2	52.00	60.00	2	200	0.5	425	39	0.05	10	0.9
35	BZV55C 62	2	58.00	66.00	2	215	0.5	450	43	0.05	10	0.9
36	BZV55C 68	2	64.00	72.00	2	240	0.5	475	48	0.05	10	0.9
37	BZV55C 75	2	70.00	79.00	2	255	0.5	500	53	0.05	10	0.9



7. 特性曲线 RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (Ta=25°C)



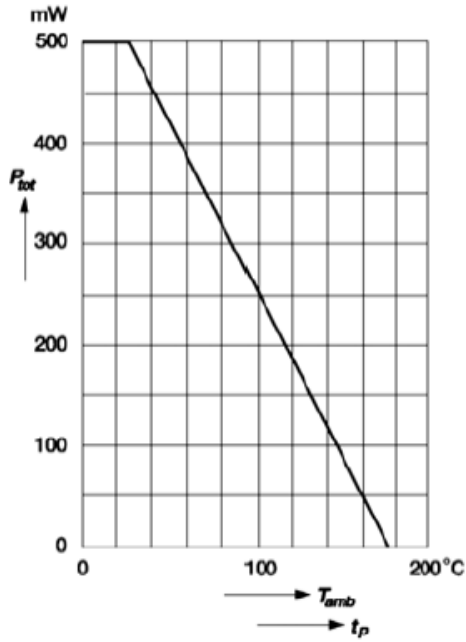


苏州固得电子股份有限公司

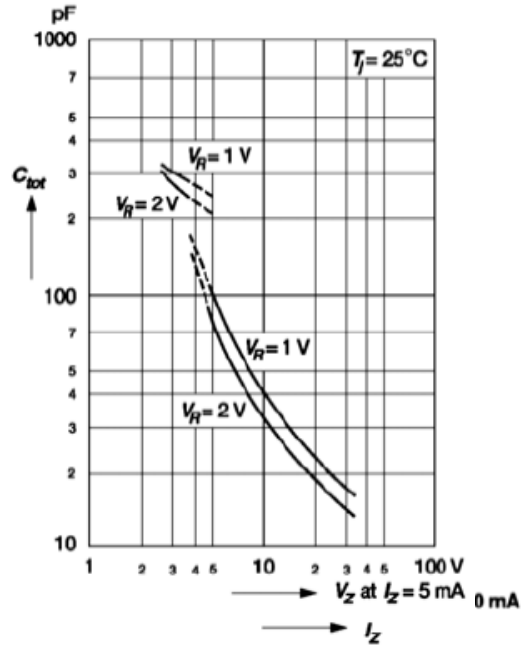
SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

Admissible power dissipation versus ambient temperature

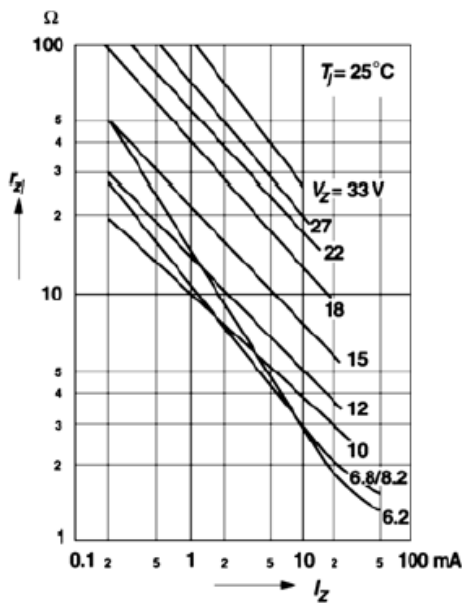
Valid provided that leads are kept ambient temperature at a distance of 8 mm from case.



Capacitance versus Zener voltage

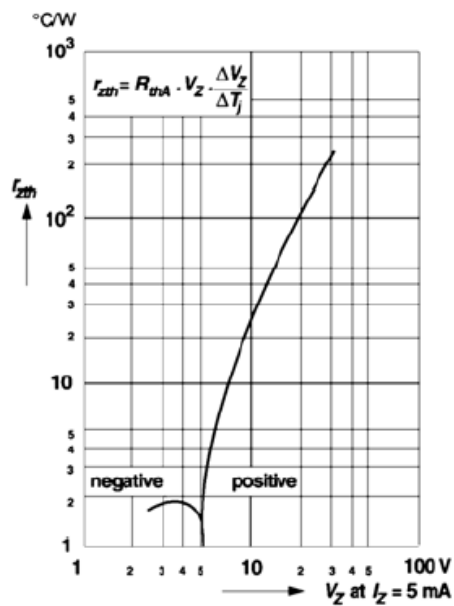


Dynamic resistance versus Zener current



Thermal differential resistance versus Zener voltage

Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case.

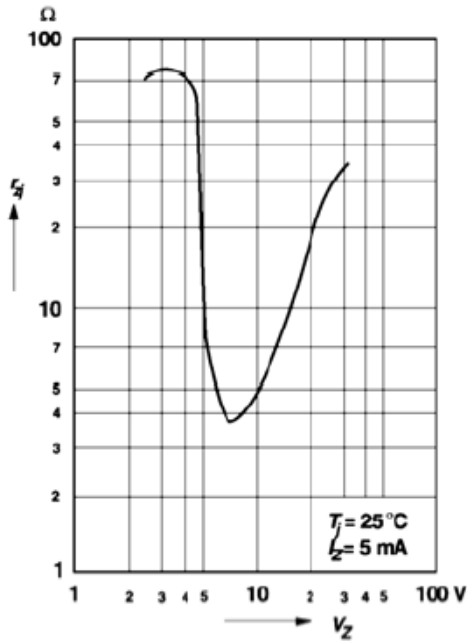




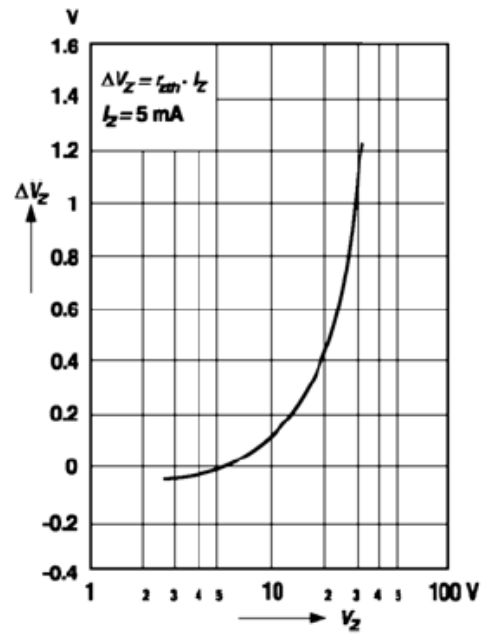
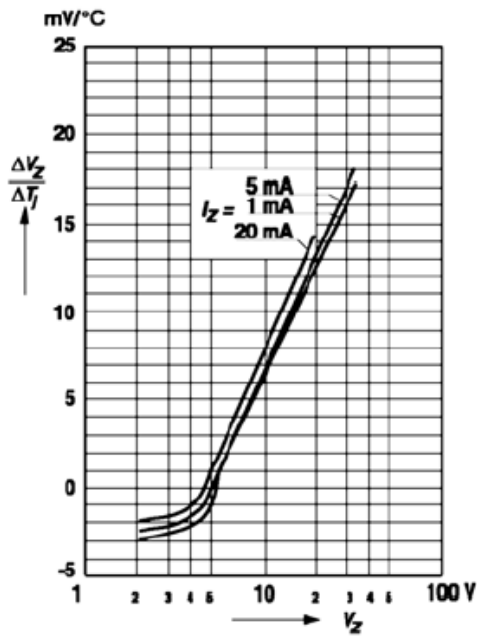
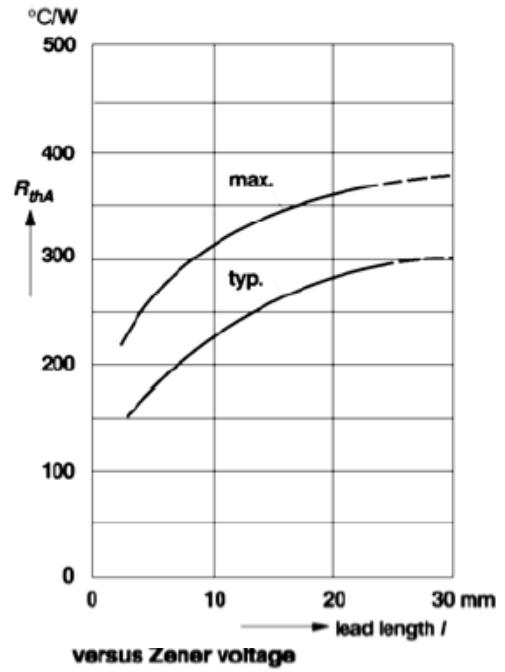
苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

Dynamic resistance versus Zener voltage



Thermal resistance versus lead length

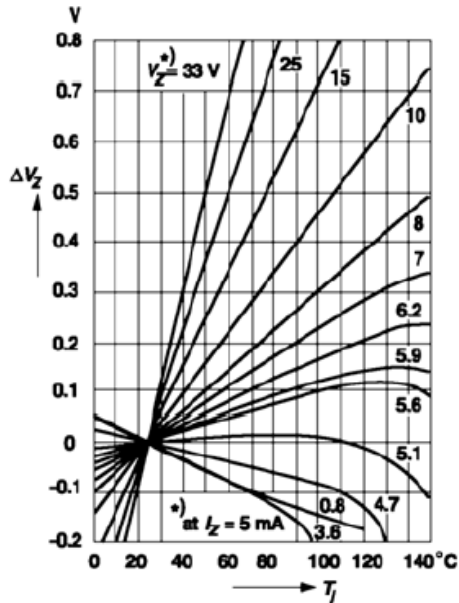




苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

Change of Zener voltage versus junction temperature



8. 包装规格 PACKAGING SPECIFICATION

8.1 卷盘、内盒、外箱标贴式样及说明见下表:





序号	材料包装形式	卷盘/内盒标贴尺寸	卷盘/内盒标贴内容说明	外箱标贴尺寸	外箱标贴内容说明
1	LL-34	卷盘65*30mm 	DEVICE: 规格 QTY: 数量 LOT NO: 生产批号 QC: PASS章	101*76mm 	DEVICE: 规格 CASE: 封装形式 QTY: 数量 DATE: 生产周期 CO/NO: 箱号 N. W. 净重 G. W. 毛重 P/O NO: 定单号 QA: PASS章
		内盒100*60mm 	DEVICE: 规格 CASE: 封装形式 QTY: 数量 LOT NO: 批号 QC: PASS章		



苏州固锴电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

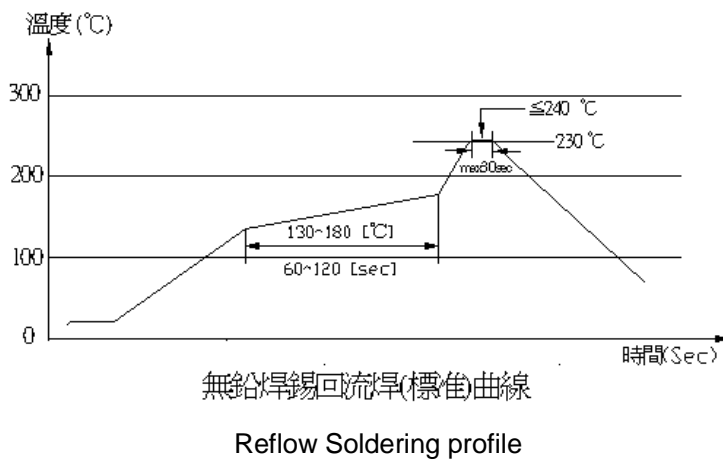
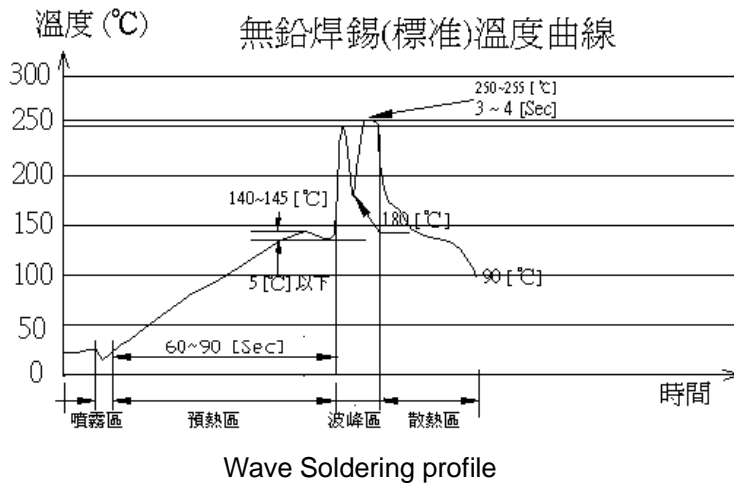
8.2 卷装包装规范见下表:

	外形尺寸 mm	数量	产品装置	标贴位置
内盒	194×185×120	25000PCS/盒	 1列10层叠放	 贴在箱体侧面左上角，箱体上印刷有pb-free无铅标识。
外箱	395×265×223	100000PCS/箱	 横放2排1层	 贴在箱体侧面左上角，印刷有GOOD-ARK 黄胶带封口，箱体上印刷有pb-free无铅标识。



9. 其他项目 OTHER ITEM.

9.1 焊接温度



9.2 焊接注意事项

- (1) 手工焊接的烙铁顶端温度（接触部位）在360°C以下、5秒以内；
- (2) 不要将烙铁顶端直接接触玻壳等；
- (3) 焊接过程中，260°C下的时间不得超过10秒；
- (4) 焊接后不要急冷，要自然冷却；
- (5) 焊接过程中和刚焊接好时，应避免任何力作用在本体和引线上；
- (6) 焊接结束后，不要推拉或扭动本体来纠正焊接位置；



苏州固得电子股份有限公司

SUZHOU GOODARK ELECTRONICS CO., LTD

10. 可靠性试验 QUALITY ASSURANCE TEST CONDITION

Test Items and its conditions

Sort	Test items	Conditions	Tested sample quantity	Failed quantity
Life test	Forward Ope. Life Test Test	Ta=25°C, Ptot: 80% t:1000hrs	22	0
	HTRB	VBR:80%(V); TA:125°C, t:1000hrs	22	0
	High temperature storage test	TA:200°C, t:1000 hrs	22	0
	Damp-heat steady-state test	TA:85°C, RH85%, t:1000hrs	22	0
	PCT	121°C, 2.15atm, 24hrs	22	0
Environmental test	Resistance to soldering heat test A	260°C, 10Sec, 1~1.5mm	22	0
	Resistance to soldering heat test B	310°C, 3Sec, 1~1.5mm	22	0
	Thermal shock	0°C, 30Sec, 100°C, 30 sec, within 3Sec, 10 cycles	22	0
	Temperature cycling	-65°C(30min)→25°C(10min) →175°C(30min) →25°C(10min) 5 cycles	22	0
	Solderability	Baking: 150°C 4hrs; tin dipping: 230°C, 5sec	22	0
Mechanical test	Dropping test	75cm, wooden floor, free fall, 3 times	22	0

Estimation Standards

Items	Measurement Condition	Symbol	Allowable Value		Units
			Min.	Max.	
Forward Voltage	Due to the individual specification	VFM	—	U×1.1	V
Reverse Current	Ditto	IRM	—	U×2	μA
Zener Voltage	Ditto	Vz	99%×U	101%×U	V

U shows the value the individual specification.